

令和4年度

京都実装技術研究会 オープニングセミナー

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和4年度の会員募集に先立ち、参加費無料のオープニングセミナーを以下のとおり開催します。

◇ 開催日時 令和4年6月30日（木） 13:30 ~ 15:30

◇ 開催方式 Web/会場参加 併用（講師はWebでのご講演です）

◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

◇ 内容

○半導体産業は世界の安全保障、サプライチェーンの要になって来た！

～100兆円の巨大市場に向けて爆裂的に成長し、設備投資急拡大

株式会社産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉 氏

半導体を制するものは世界を制する！これは今や世界各国の首脳部がコメントする言葉である。安全保障も政治経済もはたまた軍事防衛も、すべてのサプライチェーンは半導体が担うと言っても過言ではない。半導体産業はSDGs革命、IoT革命のコアであり次世代自動車の実現においても重要な役割を果たす。ここ10年のうちには100兆円の巨大市場を構築するのは確実であり、設備投資も急拡大することで世界経済に与えるインパクトは並大抵のものではない。今回講演では、半導体における日本の役割を中心に生産・投資の両面から現状および将来展望を最新取材をベースにレポートする。

◇ 定員 Web：応募状況により調整 会場：若干名

◇ 参加費 無料

◇ 申込締切 令和4年6月29日（水）まで

◇ 申込方法 当センターホームページからお申し込みいただけます。
（<https://www.kptc.jp/>）
※E-mail 又はFAXでもお申し込みいただけます。

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和4年度 京都実装技術研究会 オープニングセミナー申込書

会社名			
所在地			
連絡担当者	所属・役職		
	氏名		
	E-mail		
	電話番号		
参加者	所属・役職	氏名	
参加方法	<input type="checkbox"/> Web 参加 <input type="checkbox"/> 会場参加		
研究会入会案内の送付を希望※1		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	

※1 すでに入会申込済みの方は「しない」にチェックを付けて下さい。

※2 申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1事業所1接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。